КИНЕТИКА ФОРМИРОВАНИЯ НАНОСТРУКТУРЫ ПРИ ГИДРАТАЦИОННОМ ТВЕРДЕНИИ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ

Белорусский национальный технический университет. г. Минск, Республика Беларусь

При кристаллизации байерита из раствора происходит одновременно два основных процесса: рост кристаллитов и контактных перешейков между ними. Для аналитического описания этих процессов удобно их разделить, положив в основу разделения чисто геометрические признаки и представляя пористое тело в виде системы растущих сферических частиц байерита до их соприкосновения в точках при отсутствии перемещения в пространстве.

Цель работы — аналитически и экспериментально с помощью растрового электронного микроскопа марки LEO 1455VP фирмы «Карл Цейс» (ФРГ) изучить кинетику роста кристаллитов байерита и контактов между ними при нидратационного твердения алюминиевой пудры марки ПАП-2.

Рост каждого кристаллита, как и всей наноструктуры в целом контролируется диффузией иона алюмината через растущий слой. Кинетику роста массы т кристаллита байерита, полагая раствор идеальным, а кристаллит имеющим сферическую форму, можно выразить уравнением Фика [3]

$$\frac{\partial m}{\partial t} = DS \frac{\partial C}{\partial r},$$
 (1)

где D – коэффициент диффузии аквакомплексов алюминия в слое гидроксида илюминия, r – радиус кристаллита Al(OH)₃, S – площадь поверхности, через которую идет диффузионный массоперенос, равная

$$S = 4\pi r^2, \tag{2}$$

т - масса растущего кристаллита, составляющая

$$m = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho. \tag{3}$$

Подставив в уравнение (1) значения S и m из уравнений (2) и (3) соответственно и считая диффузию стационарной, получаем

$$r\partial t = -\frac{3D(C_0 - C)}{\rho} \partial t \tag{4}$$

где C – концентрация вещества в пересыщенном растворе; C_0 – равновесная концентрация вещества в насыщенном растворе у поверхности растущего кристаллита.

В уравнении (4) имеется неизвестная величина C_0 , которую не возможно определить экспериментально, но можно оценить, используя уравнение Гиббса при условии $\partial G = 0$:

$$\partial(nRT \ln C_O/C + \sigma S) = 0$$
, (5)

СУКЦИЯ « НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЛЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОГРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ»

где n - xимическое количество вещества Al(OH)₃, равное $n = \frac{m}{M} = \frac{4}{3} \pi r^3 \frac{p}{M}$; М

его молярная масса; ρ — истинная (пикнометрическая) плотность байерита; l' — универсальная газовая постоянная, T — абсолютная температура; σ — по верхностная энергия на границе раздела раствор-кристаллит.

После преобразований получим:

$$C_{\rm O} \approx C(1 - \frac{2\sigma V_{\rm m}}{R {\rm Tr}})$$
, (6)

где $V_m = M/\rho$ — молярный объем байерита.

Подставляя выражение (6) в уравнение (4), после интегрирования имеем $_{3}$ 6D $\sigma V_{m}C$

$$r^3 = \frac{6D\sigma V_{\rm m}C}{RT\rho} t \ , \tag{/}$$

Для получения кинетической зависимости роста радиуса кристаллита введем в уравнение (7) значения констант: коэффициент диффузии ионом алюмината в пористом слое байерита $D=10^{11}$ м 2 /с [4]; концентрации насышения алюминия в водном растворе C=0.027 кг/м 3 [5]; поверхностной энергии на границе двухгидратный гипс-вода $\sigma\approx 50\times 10^{-3}$ Дж/м 2 [6]; молярного объема гидроксида алюминия $V_m=23\times 10^{-6}$ м 3 /моль; пикнометрической плогности байерита $\rho=2.42\times 10^3$ кг/м 3 [7]; газовой постоянной R=8.31 Дж/Кмоль; температуры в системе $T\approx 373$ К. На рис.1,а приведена расчетнам кинетическая зависимость радиуса кристаллита.

Статистическая обработка экспериментальных данных (СЭМ фото рис 3) показала (рис. 2,а), что средний диаметр кристаллитов колеблется в преде лах 150-200 нм. Более крупные кристаллиты (более 300 нм) вероятно, являются агрегатами более мелких кристаллитов. Таким образом, на основании акалитических и экспериментальных исследований с достаточно высокой степенью вероятности можно предположить, что подавляющее число кристаллитов достигает размера 150 нм в первые десять минут процесса гидратационного твердения пудры, после чего кристаллиты входят в соприкосновение, и начинается рост контактных перешейков.

Поскольку пересыщение раствора выше над поверхностью твердой фазы с отрицательной кривизной, то рост кристаллитов прекращается в момсии их соприкосновения и начинается формирование фазовых контактов. Термо динамическим стимулом формирования контактов является стремление системы к уменьшению площади межфазной границы раствор/сросток кристаллитов и осуществляется за счет переноса вещества в область с отрицательным радиусом кривизны. Кинетику формирования контакта массой также можно выразить уравнением Фика:

$$\frac{\partial m_{K}}{\partial t} = DS_{K} \frac{\partial C}{\partial r}.$$
(8)

где изменение массы контакта $-\partial m_{\kappa} = \rho \partial V_{\kappa}$, площадь поверхности контакта

$$S_\kappa = \frac{2\pi x^3}{r}$$
, объем контакта $-V_\kappa = \frac{\pi x^4}{2r}$, радиус кривизны контакта $-r_k = \frac{x^2}{2r}$, [8].

а х и г – радиус контакта и радиус кристаллита, соответственно.

После преобразований

$$\frac{x^2 \partial x}{\partial t} = -\frac{2D(C_0 - C)\tau}{\rho} \tag{9}$$

В уравнении (9) неизвестно значение Со, которое можно найти из условия $\partial G = 0$:

$$\partial (nRT \ln C_0 / C + \sigma S_\kappa) = 0. \tag{10}$$

Поставив (9) в (11), получим:

$$C_0 \approx C(1 - \frac{3\sigma V_{ni}}{RTx}). \tag{11}$$

Тогда

$$x^4 = \frac{18D\sigma V_m Cr}{RT\rho}t.$$
 (12)

Вводя в уравнение (12) известные константы, рассчитаем кинетику роста контактов между кристаллитами. На рис. 1,6 приведена расчетная кинетическая зависимость радиуса контактного перешейка. Статистическая обработка жспериментальных данных (СЭМ-фото рис.3) показала (рис. 2,6), что средний диаметр контактного перешейка колеблется в пределах 70-80 нм (средний диаметр контактного перешейка колеблется в пределах 70-80 нм (средний диаметр контактного перешейка колеблется в пределах 70-80 нм (средний диаметр контактного перешейка колеблется в пределах 70-80 нм (средний диаметр контактного перешейка колеблется в пределах 70-80 нм (средний диаметр контактного перешейка колеблется в пределах 70-80 нм (средний диаметр контактного перешейка колеблется в пределах 70-80 нм (средний диаметр контактного перешейка колеблется в пределах 70-80 нм (средний диаметр контактного перешейка колеблется в пределах 70-80 нм (средний диаметр контактного перешейка колеблется в пределах 70-80 нм (средний диаметр контактного перешейка колеблется в пределах 70-80 нм (средний диаметр контактного перешейка колеблется в пределах 70-80 нм (средний диаметр контактного перешейка колеблется в пределах 70-80 нм (средний диаметр контактного перешейка колеблется в пределах 70-80 нм (средний диаметр контактного перешейка колеблется в пределах 70-80 нм (средний диаметр контактного перешейка колеблется в пределах 70-80 нм (средний диаметр контактного перешейка колеблется в пределах 70-80 нм (средний диаметр контактного перешейка колеблется в пределах 70-80 нм (средний диаметр контактного перешейка колеблется в пределах 70-80 нм (средний диаметр контактного перешейка колеблется в пределах 70-80 нм (средний диаметр контактного перешейка колеблется в пределах 70-80 нм (средний диаметр контактного перешейка колеблется в пределах 70-80 нм (средний диаметр контактного перешейка колеблется в пределах 70-80 нм (средний диаметр контактного перешейка контактного перешейка контактного перешейка контактного перешейка контактного перешейка контактного перешейка контакт

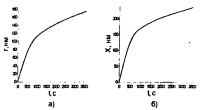


Рисунок 1 – Кинетика роста кристаллитов байерита (a) и контактных перешейков между ними (б)

пий радиус, соответственно, 35-40 нм). С достаточно высокой степенью вероигности можно предположить, что подавляющее число контактных перешейков между кристаллитами образуется в первые пять минут после соприкосно-

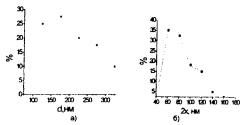


Рисунок 2 – Гистограмма распределения по размерам кристаллитов (a) и контактных перешейков (б)

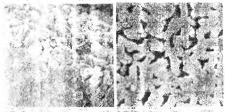


Рисунок 3 - Микроструктура системы нанокристаллитов байерита

вения последних. Относительный средний размер контактных перешейков составляет х/т≈0,27-0,3, что совпадает со значением х/т для начальной сталин спекания сферических порошков [8].

Таким образом рост кристаллитов байерита и межкристаллитных контимтов подчиняется законам диффузионной кинетики и контролируется наиболее медленной стадией процесса твердения — массопереносом ионов алюмината сквозь пористый слой байерита.

ЛИТЕРАТУРА:

- 1. Романенков, В.Е. Механизм гидратационного твердения порошковым сред / В.Е. Романенков // Новые материалы и технологии: порошковая металлургия, композиционные материалы, защитные покрытия: Матер. докл. 7-ой международной науч.-техн. конф, Минск 16-17 мая 12006 г. Минск: Институт порошковой металлургии БГНПК ПМ, 2006 г., с. 73-74.
- 2. Романенков, В.Е. Механизм начальной стадии твердения цемента/ В II Романенков // Вестник фонда фундаментальных исследований. 2007. № 1 с. 62-68.
- 3. Фролов, Ю.Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и диф персные системы / Ю.Г. Фролов. М.: Химия, 1988. 464 с.
- 4. Ратько, А.И. Гидротермальный синтез пористой металлокерамиын Al₂O₃/Al. 2. Механизм формирования пористого композита Al(OH)₃/Al / ∧ И Ратько [и др.] // Кинетика и катализ. 2004, т.45. № 1. с. 162-168.
- 5. Bersillon J., Brown J.D.W., Fissinger F., Hem J.D. Studies of hydroxyuluminium complexes in agueous solution // J. Res. U. S. Ged. Surv. 1978, № 1, P. 325-337.
- 6. Адамсон. Физическая химия поверхностей / Адамсон. М.: Мир, 1979.
- 7. Дзисько, В.А. Физико-химические основы синтеза окисных катализиторов / В.А. Дзисько, А.П. Карнаухов, Д.В. Тарасова. Новосибирск: Наука, 1978. 384 с.
- 8. Гегузин, Я.Е. Физика спекания / Я.Е. Гегузин. М.: Наука, 1984. 312 ¢